

证券代码:688233 证券简称:神工股份

锦州神工半导体股份有限公司

2024 第三季度报告

公司密切关注市场变动情况,全力拓展市场、维护客户,力争保持营收增长趋势。公司的硅零部件产品销售规模持续提升,重点客户出货品类数量持续增加,公司也不断研发新产品,为半导体设备国产自主做出独特贡献。

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:潘连胜主管会计工作负责人:刘邦涛会计机构负责人:陈琪

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:锦州神工半导体股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年9月30日
----	------------	------------

客户存款和结算备付金净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构借款净增加额

向股东借款净增加额

筹资活动现金流入小计

筹资活动产生的现金净额

客户存款和结算备付金净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构借款净增加额

向股东借款净增加额